

VEREIN DEUTSCHER
INGENIEURE
VERBAND DEUTSCHER
ELEKTROTECHNIKER

Fertigung von Leiterplatten
Verfahren zur Erhaltung der Lötbarkeit

VDI/VDE 3710

Blatt 5

Manufacturing of printed circuits boards
Conservation of soldering properties

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	2
1 Aufschmelzen mittels flüssiger Medien	2
2 Aufschmelzen mittels Infrarotstrahlung (IR)	3
3 Heißverzinnen	4
3.1 Hot-Air-Leveling	4
3.2 Walzverzinnen (Rollverzinnen)	5
4 Konservieren durch Lackieren (Schutzlackieren)	6
5 Konservieren durch Passivieren	7
6 Arbeitssicherheit und Umweltschutz (Hinweise zu A und U)	7
6.1 Arbeitssicherheit (A)	7
6.2 Umweltschutz (U)	7

Anmerkung

Beim Anwenden dieser Verfahren sind etwaige Patent- und Schutzrechte, ferner die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften und die Gebrauchsanweisungen der Lieferanten zu beachten.

Das Schrifttum ist in Richtlinie VDI/VDE 3710 Blatt 1 angegeben.

Alle mit * versehenen Begriffe sind in Richtlinie VDI/VDE 3710 Blatt 1 definiert.

VDI/VDE-Gesellschaft Mikro- und Feinwerktechnik
Ausschuß Leiterplattenfertigung